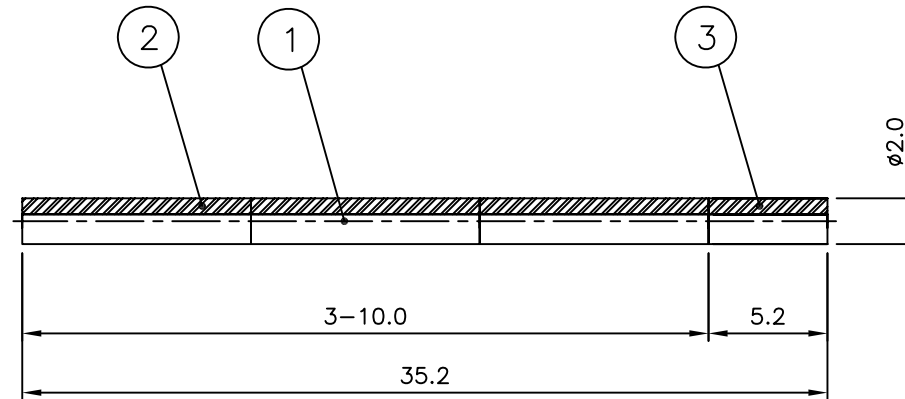


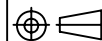
REVISION						
REV	DESCRIPTION			DRAWN	APPR	DATE
IR	Initial Registration			S.Y.EUN	I.C.KIM	2017.07.26.



* 조립 후 검사 주의사항

1. PIN과 절연체 조립 후 PIN 양끝단이 절연체 보다 돌출되지 않도록 주의 할 것.
2. PIN+절연체 조립시 헐겁지 않게 관리 필요.
(발주 진행 시 PIN 한도 견본을 절연체 외주 가공업체에 전달하여
조립 후 길이나 절연체가 헐겁지 않게 관리 될 수 있도록 내용 전달 필요.)

3	INSULATOR	1	TEFLON		DIN02926-N/1
2	INSULATOR	3	TEFLON		DIN02923-N/1
1	CONTACT	1	MBsBD C3604BD-F	Gold Plate	DCT03869-5/1
NO.	DESCRIPTION	Q'TY	MATERIAL	PLATING	CODE

TOLERANCE	Decimal	DATE 2017. 07. 26.			 RF & MICROWAVE TECHNOLOGY Tel : 82-32-347-8015 Fax : 82-32-347-8017
	Angle	APPROVED BY	I.C.KIM		
MATERIAL	±1°	CHECKED BY	TITLE BUSHING		
	_____	DRAWN BY			
FINISH	_____	SCALE 3/1	UNIT mm		A4
		DWG NO. CN03722-7/1			
		REVISION		I R	SHEET 1 of 1